



Tag der Verpackung am 9. Juni 2016

Ort: HTWK Leipzig, Nieper-Bau, Hörsaal 001

Karl-Liebknecht-Str. 134, 04277 Leipzig

Programm

- 9.00 Uhr Begrüßung
Prof. Dr.-Ing. Eugen Herzau, HTWK Leipzig
- 9.10 Uhr 3D- Druck - Chancen und Herausforderungen für die Verpackungsindustrie
Prof. Dr. rer. nat. Lutz Engisch, HTWK Leipzig
- 9.40 Uhr Anforderungen des Marktes an einen Faltschachtelhersteller
Dr. rer. nat. Harald Frank, Gebr. Frank GmbH & Co. KG
- 10.10 Uhr Besondere Anforderungen an Verpackungen für Medizinprodukte
Dipl.-Ing. Falko Staufer, SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
- 10.40 Uhr Kaffeepause
- 11.10 Uhr Verpackung und Logistik – Transportverpackung im Zeitalter von Internet of Things und Industrie 4.0
Markus Linke, Schenker Deutschland AG
- 11.40 Uhr Möglichkeiten und Grenzen des Digitaldrucks für Verpackungen
B.Eng. Simon Lober, HTWK Leipzig
- 12.10 Uhr Diskussionsrunde „Herausforderungen für die Zukunft aus Sicht der Verpackung“
- 13.00 Uhr Imbiss sponsored by Schenker Deutschland AG,
DB SCHENKEReuropac